

2013-2017年中国半导体市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2013-2017年中国半导体市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianzi1307/D5719883H2.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2013-07-10

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2013-2017年中国半导体市场分析与投资前景研究报告》共十二章。在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家经济信息中心、中国半导体行业协会、博思网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及半导体专业研究单位等公布和提供的大量资料。

通过《2013-2017年中国半导体市场分析与投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业的发展提供了科学决策依据。

2012年全球半导体增长乏力，销售额仅同比微增0.4%。但随着智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续扩大，2013年全球半导体市场景气状况将趋于好转。2012年第一季度，全球半导体营业收入比2011年第四季度温和下降3.6%，符合正常的季节模式。但第二季度营业收入仅比第一季度增长3.0%左右，从历史平均水平来看，非常疲软；第三季度，主要芯片供应商的营业收入环比增幅仅略高于6.0%。而2012年全球半导体销售额为3010亿美元，较2011年同比微增0.4%。

得益于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体需求的持续增长，2013年及以后一段时间，全球半导体市场景气状况将趋于好转。消费电子产品与互联网和移动互联网的紧密结合，导致手机、平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应用面持续扩大，随着各种电子整机产品的市场需求量大增，芯片的出货量会持续上升，半导体产业前景将十分诱人。预计2013年与2014年全球销售额可分别达到3220亿美元与3370亿美元，增长率分别为7.2%与4.4%。中国PC、手机及数字消费电子等整机产品的制造向地区转移，带动了上游芯片市场需求的增加。其中，PC首次成为中国大陆半导体市场最大的应用领域，对高阶芯片的需求量也大幅增长。

当前半导体产业的应用热点已从最初的计算机、通信扩展至消费类电子、新能源、汽车电子等领域。随着产业发展的变革，半导体行业已从单一垂直化生产向现在的扁平化结构转变，国际分工日益明显。在日益激烈的国际竞争中，世界各地遵循成本效益原则形成了以美国为主导的高端产品设计与关键技术制造，以日本、韩国为核心的大众消费品生产，以及以中国台湾及大陆地区为主体的加工封装业共同发展的产业格局。受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，世界半导体产业呈现向具有成本优势、市场优势的发展中国家产业链转移的趋势。作为经济高速增长的发展主体，我国依托庞大的市场需求及生成要素

成本优势成为国际半导体产业转移的主要目的地，以欧美、台湾地区为主的大型半导体制造业通过OEM、并购、合资等多种方式向我国转移半导体产业。

报告目录

第一章 半导体的概述

第一节 半导体行业的简介

- 一、半导体
- 二、本征半导体
- 三、多样性及分类

第二节 半导体中的杂质

- 一、PN结
- 二、半导体掺杂
- 三、半导体材料的制造

第三节 半导体的历史及应用

- 一、半导体的历史
- 二、半导体的应用
- 三、半导体的应用领域

第二章 半导体行业的发展概述

第一节 半导体行业历程

- 一、中国半导体市场规模成长过程
- 二、全球半导体行业市场简况
- 三、中国半导体行业市场简况
- 四、中国在国际半导体行业地位
- 五、全球半导体行业市场历程

第二节 中国集成电路回顾与展望

- 一、十年发展迈上新台阶
- 二、机遇与挑战并存
- 三、着力转变产业发展方式
- 四、充分推动国际合作与交流

第三节 半导体行业的十年变化

- 一、半导体产业模式fablrite的新思维
- 二、全球代工版图的变化

- 三、推动产业发展壮大的捷径
- 四、三足鼎立
- 五、两次革命性的技术突破
- 六、尺寸缩小可能走到尽头
- 七、硅片尺寸的过渡
- 八、3D封装与TSV最新进展
- 九、未来半导体行业的趋向
- 十、2000-2012年在半导体行业中发生的重要事件

第三章 化合物半导体电子器件研究与进展

第一节 化合物半导体电子器件的出现

- 一、化合物半导体电子器件简述
- 二、化合物半导体电子器件发展过程
- 三、化合物半导体电子器件发展难题

第二节 化合物半导体领域发展现状

- 一、化合物半导体领域研究背景
- 二、化合物半导体领域发展现状
- 三、关注化合物半导体的一些难题

第三节 化合物半导体的未来趋势

- 一、引领信息器件频率、
- 二、高迁移率化合物半导体材料
- 三、支撑信息科技创新突破
- 四、引领绿色微电子发展
- 五、化合物半导体的期望

第四章 功率半导体技术与发展

第一节 功率半导体概述

- 一、功率半导体的重要性
- 二、功率半导体的定义与分类

第二节 功率半导体技术与发展状况

- 一、功率二极管
- 二、功率晶体管

三、晶闸管类器件

四、功率集成电路

五、功率半导体发展探讨

第五章 半导体集成电路技术与发展

第一节 半导体集成电路的总体情况

一、集成电路产业链格局日渐完善

二、集成电路设计产业群聚效应日益凸现

三、集成电路设计技术水平显著提高

四、人才培养和引进开始显现成果

第二节 集成电路设计

一、自主知识产权CPU

二、第三代移动通信芯片

三、数字电视芯片

四、动态随机存储器

五、智能卡专用芯片

六、第二代居民身份证芯片

第三节 集成电路制造

一、极大规模集成电路制造工艺

二、技术成果推动了集成电路制造业的发展

三、面向应用的特色集成电路制造工艺

第四节 半导体集成电路封装

一、半导体封装产业的历程

二、集成电路封装产业保持增长

三、集成电路封装的突破

四、集成电路封装的发展

第六章 全球半导体行业经济分析

第一节 金融危机后的半导体行业

一、美国经济恶化将影响全球半导体行业

二、日本大地震影响全球半导体产业链上游

三、全球半导体行业仍呈稳健成长趋势

四、全球经济刺激计划带动半导体行业复苏

五、全球半导体行业经济复苏中一马当先

第二节 全球半导体行业经济数据透析

一、2012年半导体的销售额

二、2011年半导体行业的市场规模

三、2012年半导体行业产值

第七章 全球半导体行业的发展趋势

第一节 半导体行业发展方向

一、半导体硅周期放缓

二、半导体产业将是独立半导体公司的天下

三、推动未来半导体产业增长的主动动力

四、摩尔定律不再是推动力

五、SOC已经遍地开花

六、整合、

七、私募股份投资公司开始瞄准业界

八、无晶圆厂IC公司越来越发达

第二节 新世纪MEMS技术创新发展

一、MEMS技术的发展

二、新兴MEMS器件的发展

三、发展的机遇

第三节 半导体集成电路产业的发展

一、集成电路历史发展概况

二、世界集成电路产业发展的一些特点和趋势

三、集成电路产业的机遇和挑战

四、集成电路产业发展及对策建议

五、中国集成电路产业发展路径

六、集成电路产业前瞻

第四节 全球半导体行业的障碍及影响因素

一、半导体行业主要障碍

二、影响半导体行业发展的因素

第八章 中国半导体行业的经济及政策分析

第一节 中国半导体行业的冲击

- 一、上海半导体制造设备进口主要特点
- 二、上海半导体制造设备进口激增的原因
- 三、强震造成的问题及建议

第二节 半导体行业经济发展趋势明朗

- 一、我国半导体行业高度景气阶段
- 二、我国半导体行业快速增长原因分析
- 三、我国半导体行业增长将常态化
- 四、半导体行业蕴藏机会

第三节 半导体行业政策透析

- 一、中国半导体产业发展现状
- 二、中国半导体的优惠扶持政策
- 三、中国大陆半导体产业的政策尴尬

第九章 中国半导体行业机会

第一节 产业分析

- 一、太阳能电池产业
- 二、IGBT产业
- 三、高亮LED产业
- 四、光通信芯片产业

第二节 中国半导体产业面临发展机会

- 一、太阳能电池产业发展现状
- 二、中国IGBT产业市场发展潜力
- 三、高亮LED产业
- 四、光通信芯片产业

第十章 中国半导体集成电路产业的发展与展望

第一节 北京集成电路产业

- 一、北京集成电路产业发展回顾
- 二、北京集成电路产业发展展望

第二节 江苏省集成电路产业发展与展望

一、江苏省集成电路产业发展回顾

二、江苏省集成电路产业发展环境

三、江苏省集成电路产业发展展望

第三节 上海集成电路产业发展与展望

一、十年辉煌成果

二、上海集成电路产业在全球、

三、上海集成电路产业发展环境日益优越

四、上海集成电路产业的美好发展前景

第四节 深圳集成电路产业发展与展望

一、地区产业发展

二、产业结构与技术创新能力

三、资源优化与整合经验

四、地区产业发展环境

五、深圳IC设计产业在“十二五”期间的发展目标

第五节 中国半导体行业在创新中发展

一、2002-2011年产业发展状况

二、产业发展面临的问题

三、产业发展的任务

第十一章 中国半导体企业的发展状况

第一节 中国南玻集团股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第二节 方大集团股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第三节 有研半导体材料股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第四节 吉林华微电子股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第五节 南通富士通微电子股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第六节 江西联创光电科技股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第七节 上海贝岭股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第八节 天水华天科技股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第九节 宁波康强电子股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第十节 大恒新纪元科技股份有限公司

一、公司概况

二、2011-2012年公司财务比例分析

三、公司未来发展

第十二章 2013-2017年半导体行业发展环境

第一节 创新是半导体行业发展的推动力

一、延续平面型CMOS晶体管—全耗尽型CMOS技术

二、采用全新的立体型晶体管结构

三、新沟道材料器件

四、新型场效应晶体管

第二节 硅芯片业的重要动向

一、从Apple和Intel二类IT公司转型说起

二、软硬融合

三、业务融合

四、服务至上

第三节 2013-2017年半导体行业预测

一、无线半导体行业进一步整合

二、英特尔公司获得ARM公司Cortex处理器授权

三、三星大量生产调制解调器

四、苹果公司推出基于iOS的MacBookAir笔记本电脑

五、电信基础设施行业进一步结构调整

六、分销协议

七、手机业的并购与重组

八、2013年年中苹果公司推出量身打造的“迷你”iPhone

九、Windows8和WindowsPhone

十、2013年下半年苹果公司推出智能电视

第四节 半导体产业三大发展趋势

一、多样化

二、平台化发展

三、低功耗到云端

图表目录

图表：2001-2012年我国集成电路销售额及增长率

图表：2001-2012年我国集成电路设计业、制造业和封测业销售收入情况

图表：2009-2012年台积电全球代工市场份额

图表：2012年全球代工排名

图表：硅片尺寸过渡与生存周期

图表：“申威1”处理器

图表：“申威1600”处理器

图表：“神威蓝光”高性能计算机系统

图表：国家首款卫星数字电视信道接收芯片GX1101及高频头

图表：国家首款有线数字电视信道接收芯片GX1001及高频头

图表：国家首款数字视频后处理芯片GX2001及应用开发板

图表：国产首款解调解码SoC芯片GX6101构成的开发板

图表：CX1501+GX3101构成DTMB/AVS双国际机顶盒

图表：国产动态随机存储器芯片

图表：山东华芯DDR2芯片构筑的内存条及应用

图表：2011年封装市场企业数量统计

图表：我国主要IC封测企业

图表：我国主要半导体分立器件封测企业

图表：我国主要封装测试设备与模具生产企业

图表：我国主要LED封装企业

图表：国内主要金属、陶瓷封装企业

图表：国内电子封装技术教育资源

图表：国内集成电路封装测试业统计表

图表：国内封装测试企业的地域分布情况

图表：2010年中国半导体创新产品和技术的IC封装与测试技术

图表：日本国内主要半导体企业受大地震影响情况

图表：我国半导体行业销售增长情况

图表：我国半导体行业销售利润率增长情况

图表：我国集成电路产量及同比增长情况

图表：我国半导体分立器件产量及同比增长情况

图表：我国集成电路出口及贸易平衡情况

图表：全球电脑季度出货量及同比增长情况

图表：全球智能手机季度出货量及同比增长情况

图表：全球半导体行业销售收入及同比增长情况

图表：全球半导体行业产能利用率情况

图表：全球半导体设备订单出货比变化情况

图表：我国主要半导体产品市场价格指数走势情况

图表：我国集成电路销售收入及同比增长情况

图表：全球计算机出货量及同比增长情况

图表：我国集成电路出口额及同比增长情况

图表：2006-2011年IC进口额及占比

图表：2012年电子元器件价格指数

图表：螺纹管HRB33520MM上海市场行情

图表：2003-2011年北京集成电路销售收入及增长率

图表：2003-2011年北京集成电路产业各环节

图表：2003-2011年北京集成电路制造企业销售收入及增长率

图表：2003-2011年北京集成电路封装和测试企业销售收入及增长率

图表：2003-2011年北京集成电路产业装备材料企业销售收入及增长率

图表：江苏省半导体企业风分布

图表：2002-2011年江苏省集成电路产业销售收入

图表：2002-2011年江苏省半导体分立器件销售收入

图表：2005-2011年江苏省半导体分立器件销售收入占全国同业比重

图表：2002-2011年江苏省集成电路产业销售收入占全国同业比重

图表：2001-2011年的十年间上海集成电路产业销售规模和增长率

图表：2001-2011年上海集成电路产量规模

图表：2001-2011年上海集成电路产业出口额变化

图表：2001-2011年上海集成电路产业累积投资额

图表：2001-2011年上海集成电路产业的企业数量及从业人数

图表：2001-2011年上海集成电路产业技术水平

图表：2001-2011年上海集成电路产业占全球、全国半导体产业的比重

图表：2011-2015年上海集成电路产业的销售规模及增长率

图表：2004-2011年深圳IC设计企业销售额

图表：2011销售额前25名深圳IC设计企业

图表：2011年深圳集成电路设计企业人数分布

图表：深圳市典型IC设计企业设计水平

图表：深圳市IC设计企业特征线宽分布

图表：深圳市IC设计企业IP使用情况

图表：2002-2011年深圳集成电路设计企业销售额

图表：2002-2011年深圳市IC设计机构数量

图表：深圳IC制造企业情况

图表：2002-2011年半导体销售额增长情况

图表：2002-2011年集成电路销售额增长情况

图表：2002年集成电路产业结构

图表：2011年集成电路产业结构

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司投资收益分析

图表：2012年中国南玻集团股份有限公司资产负债分析

图表：2012年中国南玻集团股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司投资收益分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年方大集团股份有限公司发展能力分析

图表：2012年方大集团股份有限公司资产负债分析

图表：2012年方大集团股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司投资收益分析

图表：2012年有研半导体材料股份有限公司资产负债分析

图表：2012年有研半导体材料股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司投资收益分析

图表：2012年吉林华微电子股份有限公司资产负债分析

图表：2012年吉林华微电子股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司投资收益分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司经营效率分析

图表：2012年南通富士通微电子股份有限公司资产负债分析

图表：2012年南通富士通微电子股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司投资收益分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司经营效率分析

图表：2012年江西联创光电科技股份有限公司资产负债分析

图表：2012年江西联创光电科技股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司投资收益分析

图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司现金流量分析

图表：2012年上海贝岭股份有限公司资产负债分析

图表：2012年上海贝岭股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司投资收益分析

图表：2012年天水华天科技股份有限公司资产负债分析

图表：2012年天水华天科技股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司投资收益分析

图表：2012年宁波康强电子股份有限公司资产负债分析

图表：2012年宁波康强电子股份有限公司利润分配分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司获利能力分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司偿债能力分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司资本结构分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司经营效率分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司发展能力分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司现金流量分析

图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司投资收益分析

图表：2012年大恒新纪元科技股份有限公司资产负债分析

图表：2012年大恒新纪元科技股份有限公司利润分配分析

略……

本半导体行业报告，对我国半导体的行业现状、市场各类经营指标的情况、关联产业的发

展状况、重点企业状况、产业竞争格局等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对半导体市场发展动向作了详尽深入的分析，对半导体未来的发展趋势作了审慎的判断，为半导体产业投资者寻找新的投资机会。最后阐明半导体行业的投资空间，指明投资方向，提出研究者的战略创新建议，以供投资决策者参考。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianzi1307/D5719883H2.html>